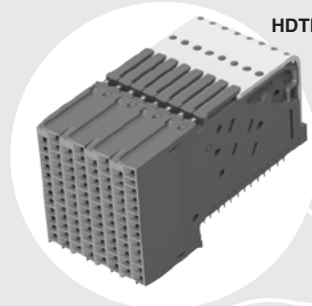


XCede HD



HDTF-4-08-S-RA-LC-100



HDTF-4-04-S-RA-LC-100

HDTF SERIES

(1.80 mm) .071"

XCede® HD BACKPLANE RECEPTACLE

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?HDTF

- Insulator Material:** Liquid Crystal Polymer
- Contact Material:** Copper Alloy
- Plating:** Sn or Au over 50 μ" (1.27 μm) Ni
- Operating Temp Range:** -40 °C to +105 °C
- Current Rating:** Testing Now!
- RoHS Compliant:** Yes

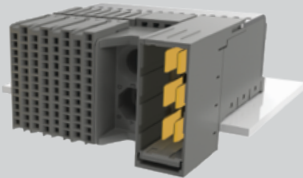
RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality



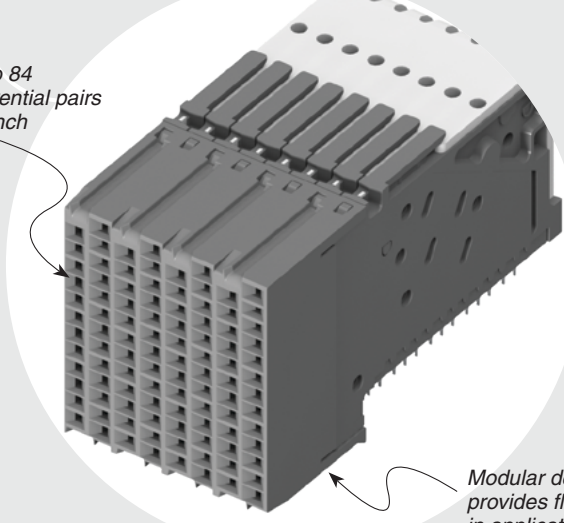
Mates with:
HDTM

ALSO AVAILABLE (Customer Defined Configurations)



Power and keying/guidance modules also are available but require a single customizable BSP product. A BSP product is built by combining any number, in any configuration, of HDTFs, power and keying/guidance modules to create one receptacle. Contact HSBP@samtec.com for more information about building a BSP product.

Up to 84 differential pairs per inch



Modular design provides flexibility in applications

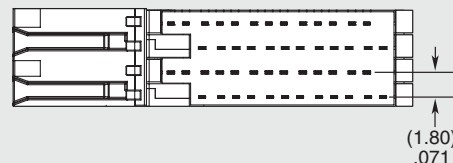
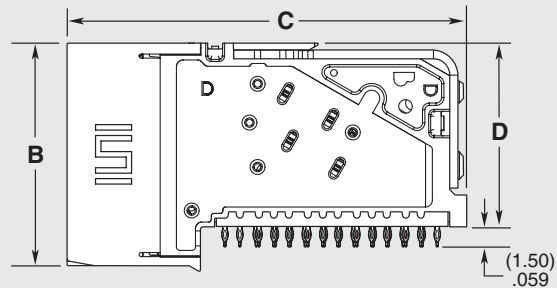
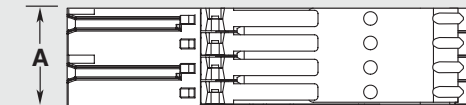
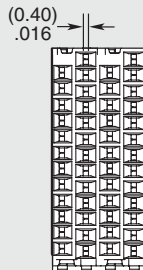
TOOLING

- For press-fit extraction and insertion tool options, visit www.samtec.com/tooling

HDTF	PAIRS PER COLUMN	NO. OF COLUMNS	PLATING	RA	WAFERS	IMPEDANCE
-3, -4, -6	= Pairs Per Column	-04 = Four Columns -06 = Six Columns -08 = Eight Columns	-S = 30 μ" (0.76 μm) Gold in contact area, Matte Tin on tail	-LC = Standard -HS = High-Speed	-100 = 100 Ω -085 = 85 Ω	

NO. OF COLUMNS	A
-04	(7.2) .28
-06	(10.8) .42
-08	(14.4) .57

PAIRS PER COLUMNS	B	C	D
-3	(12.8) .50	(26.0) 1.02	(9.80) .386
-4	(16.4) .64	(29.4) 1.16	(13.5) .53
-6	(23.6) .93	(36.6) 1.44	(20.7) .81



Note:
XCede® is a registered trademark of Amphenol.

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications. Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.